

「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」及「擬定高雄新市鎮特定區細部計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」

都市計畫公開展覽傳單

主旨：舉辦「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」及「擬定高雄新市鎮特定區細部計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」公開展覽說明會。

依據：依據都市計畫法第 19 條及第 27 條第 1 項第 3 款規定辦理。

說明：

一、「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」及「擬定高雄新市鎮特定區細部計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」之公告公開展覽自民國 114 年 2 月 14 日起至 114 年 3 月 16 日止。

二、展覽地點：

- (一) 高雄市政府都市發展局都市計畫公告欄。
- (二) 高雄市岡山區公所、橋頭區公所公告欄。
- (三) 高雄市政府都市發展局網站：<http://urban-web.kcg.gov.tw/>→「都市計畫專區」→「都市計畫公告」→選擇「公告公開展覽」→搜尋及點選本計畫案名。
- (四) 內政部國土管理署網站：<https://www.nlma.gov.tw>→「政府資訊公開」→選擇「說明會」→點選本計畫案名。

三、說明會時間及地點：

說明會日期	時間	地點
114 年 2 月 24 日 (星期一)	上午 11 時整	岡山區公所 3 樓會議室 (高雄市岡山區岡山路 343 號)
114 年 2 月 25 日 (星期二)	上午 11 時整	橋頭區公所 3 樓會議室 (高雄市橋頭區隆豐路 1 號)

四、公開展覽期間任何公民或團體如有意見，得於公開展覽期間內，以書面載明姓名或名稱及地址，並依格式(如附件)向高雄市政府提出。公開展覽期滿後，由高雄市政府彙整函轉內政部，俾供內政部都市計畫委員會審議參考。

「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」及「擬定高雄新市鎮特定區細部計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」

都市計畫變更內容概要

一、計畫緣起

依行政院「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，以位於楠梓區之原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港（大林埔）半導體材料、石化聚落，建立南部半導體材料S形廊帶。為延續前述產業廊帶與厚植南部半導體產業發展量能將選定產業儲備用地-白埔農場，原為經濟部「中南部產業園區開發方案」，為滿足半導體先進製程企業之需求，並依行政院「白埔農場開發相關議題研商會議」（院臺長長字第 1125004172 號）指示由高雄市政府先行啟動產業園區相關作業。依「產業創新條例」選定高雄市岡山區及橋頭區之白埔農場作為白埔產業園區（以下簡稱「本計畫」）之基地範圍，以提供優良產業用地，吸引半導體廠商擴廠投資，強化南部半導體材料S廊帶之發展，並引領高雄市產業朝高值化方向發展與深化產業發展根基，進而促進地方整體經濟繁榮與提供充足之就業機會。

爰此，高雄市政府為促進高雄市經濟與產業發展，以及滿足廠商用地需求，及配合本計畫申請設置作業，並經內政部於 113 年 10 月 4 日台內國字第 1130810970 號函認定符合都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款規定，辦理本次個案變更(以下簡稱：本計畫)，以利產業園區申請設置程序之進行，俾利後續園區工程之推動。高雄市政府另依「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」之規定，於民國 112 年 12 月 4 日召開都市計畫變更前座談會。

二、計畫範圍

本計畫變更位置位於高雄市岡山及橋頭區交界處之白埔農場，計畫面積約 88.73 公頃，東側緊鄰台 1 線、西側鄰近典寶溪生態滯洪池、南側鄰近橋頭再生水廠及住宅區、北側則鄰近大遼排水，計畫範圍屬高雄新市鎮特定區計畫。另以交通位置論之，本基地東側有台 1 線、市道 186、國道 1 號以及捷運岡山高醫站、台鐵橋頭火車站，周邊聯絡道

路及大眾運輸系統發達，往來市區與城際間交通便利。計畫範圍周界如下(詳圖 2)。

1. 東界：省道台 1 線(岡山南路、成功北路)
2. 南界：橋頭污水處理廠及住宅區(林子頭社區)
3. 西界：典寶溪滯洪池及私有土地
4. 北界：大遼排水

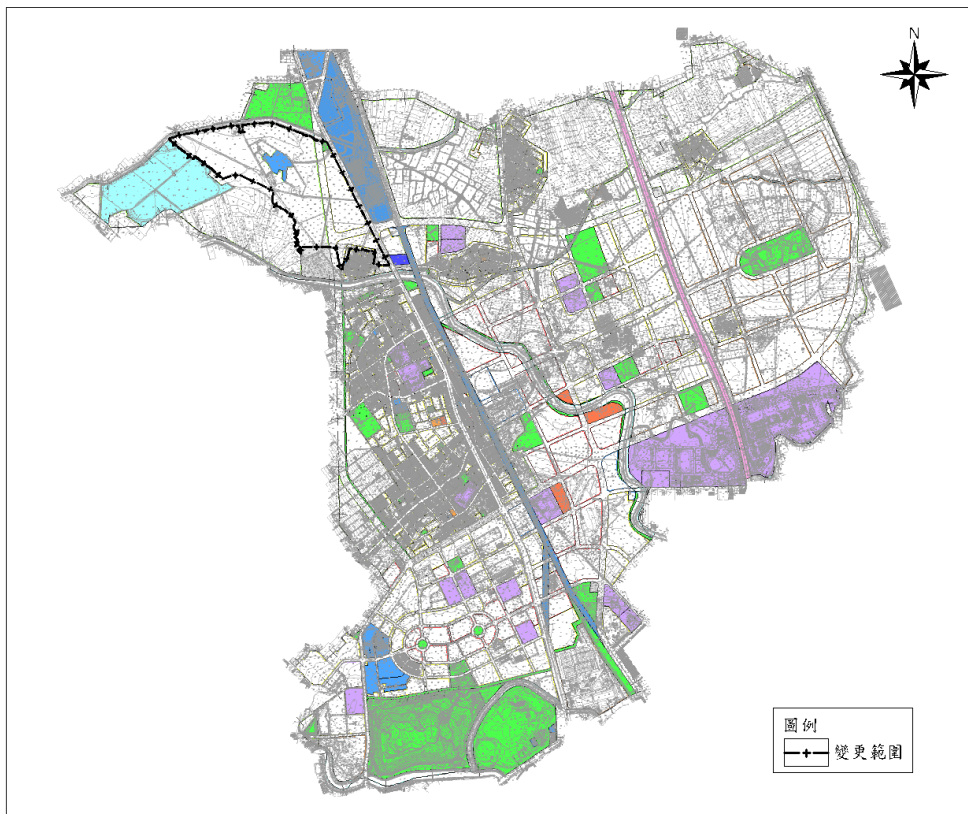


圖1 計畫地區之位置圖

資料來源：本計畫繪製。

三、變更內容

(一)「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」

本計畫依據《都市計畫法》及《產業創新條例》，配合產業園區之計畫目的、目標產業發展需求及性質，並依據前述變更原則，規劃產業專用區約占 60.44%，住宅區約佔 1.71%、公共設施用地約占 37.63%(詳本案細部計畫)。本計畫主要變更內容詳表 1，變更內容示意詳圖 2。

表 1 主要計畫變更內容綜理表

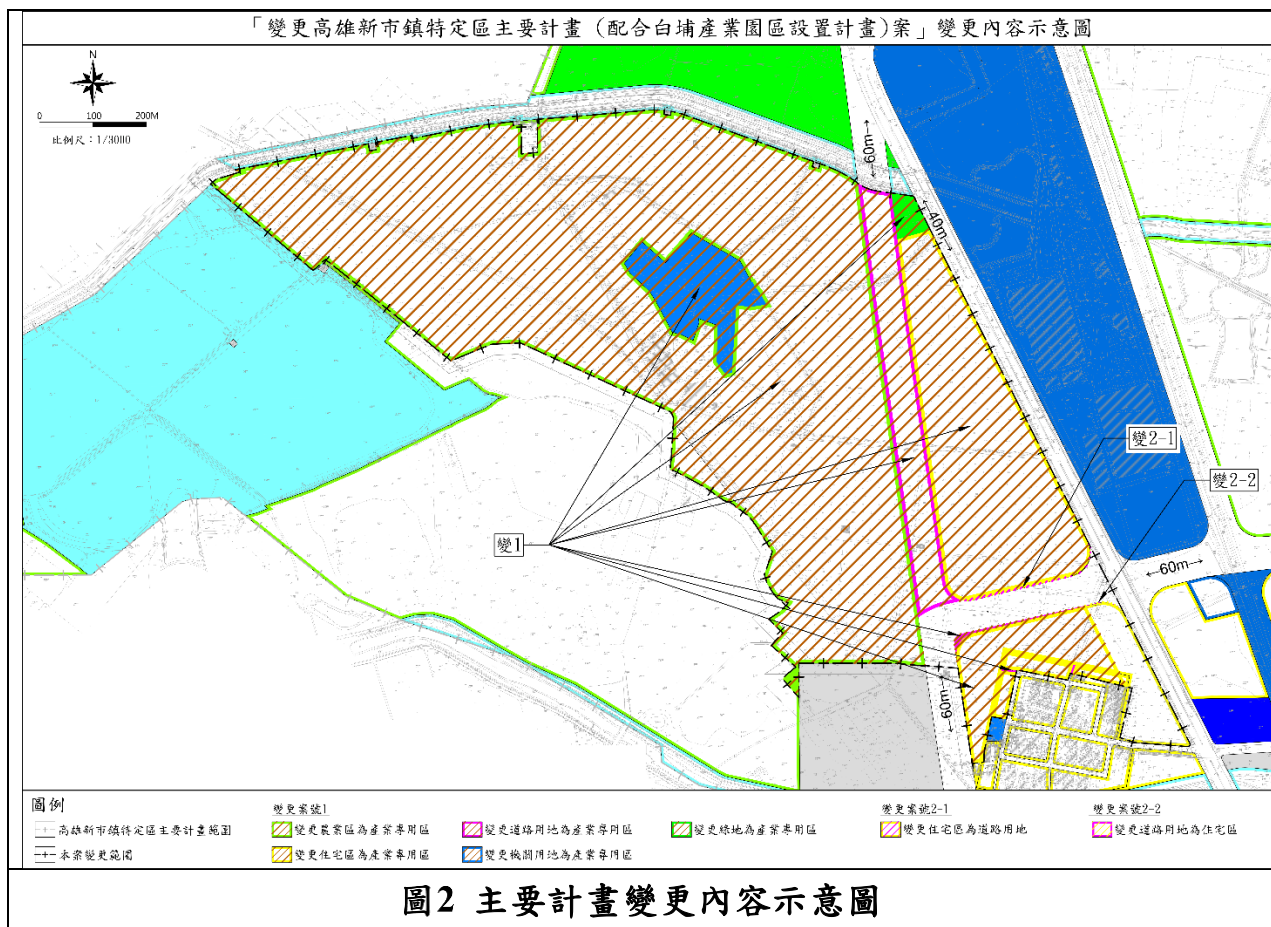
位置	案號	變更內容		變更理由
		原計畫 (公頃)	新計畫 (公頃)	
原台糖白埔農場，岡山區清水段、街尾崙段以及橋頭區德松段及芋林段等共 135 筆土地	變 1	農業區 (59.60)	產業專用區 (84.08)	1. 配合南部半導體材料 S 廊帶發展：依行政院「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」配合建立並強化南部半導體材料 S 廊帶鏈結。並依行政院「白埔農場開發相關議題研商會議」（院臺長字第 1125004172 號）啟動產業園區相關作業，滿足相關廠商潛在需求。 2. 依循高雄市國土計畫指導之發展方向：本計畫位屬製造業發展區位之高發展區，可鍊結周邊產業園區，形塑產業聚落。
		住宅區 (16.13)		
		道路用地 (4.88)		
		機 14 用地 (3.07)		
		綠地用地 (0.40)		
	變 2-1	住宅區 (0.05)	道路用地 (0.05)	3. 既有工業區使用已飽和：高雄市各科學園區及科技產業園區、編定工業區中產業用地幾已售罄或完租；鄰近都市計畫工業區皆開闢 8 成以上，幾乎無適宜產業用地可再釋出。本計畫預計可提供 53.63 公頃之產業用地，以滿足廠商產業用地需求。 4. 本次為配合白埔產業園區設置計畫變更主要計畫，本次因應變更開發方式，原則以協議價購、一般徵收或租用等方式辦理。並將依「產業創新條例」第 37 條與「產業園區委託申請設置規劃開發租售管理辦法」之規定，公開甄選公民營事業辦理產業園區規劃、開發、租售及管理業務，及籌措本計畫開發計畫所需資金。
	變 2-2	道路用地 (0.0031)	住宅區 (0.0031)	

位置	案號	變更內容		變更理由
		原計畫 (公頃)	新計畫 (公頃)	
				5. 園區計畫範圍南側包括「高雄新市鎮特定區主要計畫案」之「1-2 號道路」部份路段(路寬 60 公尺)，因應銜接園區內 15 米道路(詳本案細部計畫)微調路型，以健全園區相關路型規劃。

註：1.表內所載面積應以核定計畫圖實地分割面積為準。

2.本計畫未變更部分，均應以原計畫為準。

資料來源：本計畫整理。



註：本計畫未變更部分，均應以原計畫為準。

資料來源：本計畫繪製。

(二) 「擬定高雄新市鎮特定區細部計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」

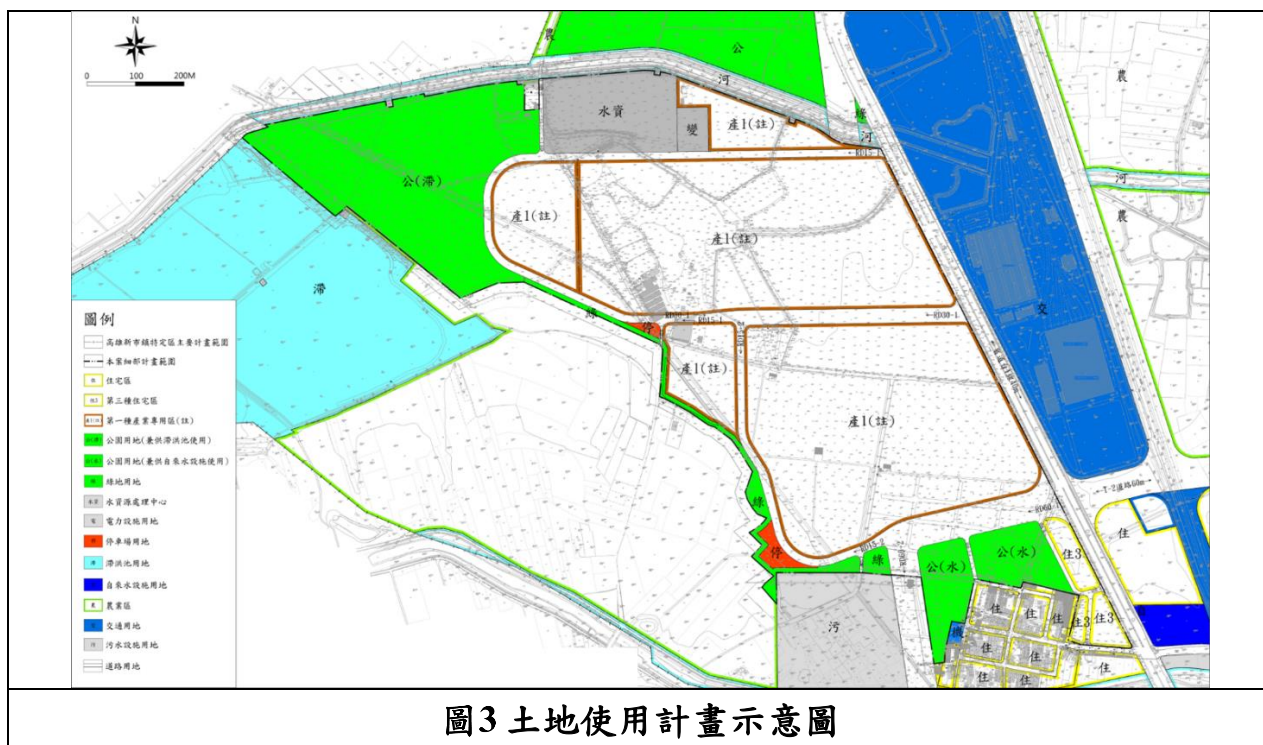
本計畫依據「都市計畫法」及「產業創新條例」，配合產業園區之計畫目的、目標產業發展需求及性質，並依據前述變更原則，規劃第一種產業專用區(註)約占 60.44%，公共設施用地約占 37.63%，土地使用面積分配詳表 1，土地使用計畫詳圖 3。

表 2 土地使用計畫面積分配表

土地使用		面積(公頃)	百分比	備註或附帶條件
土地使用分區	第一種產業專用區(註)	53.63	60.44%	第一種產業專用區(註)依「產業創新條例」之「產業園區各種用地用途及使用規範辦法」產業用地(一)訂定相關容許使用。
	第三種住宅區	1.71	1.93%	第三種住宅區為依「產業創新條例」第46條規定劃設之社區用地。
	小計	55.34	62.37%	-
公共設施用地	公園用地(兼供滯洪池使用)	14.09	15.88%	-
	公園用地(兼自來水設施使用)	3.93	4.43%	-
	水資中心用地	4.44	5.00%	-
	電力設施用地	0.58	0.65%	-
	停車場用地	0.52	0.59%	-
	綠地用地	1.80	2.03%	-
	道路用地	8.03	9.05%	-
	小計	33.39	37.63%	-
總計		88.73	100.00%	

註：園區實際面積應以地籍實地測量分割面積統計為準。

資料來源：本計畫整理。



註：本計畫未變更部分，均應以原計畫為準。

資料來源：本計畫繪製。